

## Storage Area Networks:

## Mehr als drei Millionen Ports

Der Hersteller von Netzinfrastruktur-Einrichtungen für Storage Area Networks (SANs), Brocade Communication Systems ([www.brocade.com](http://www.brocade.com)), konnte im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2003 wesentliche Meilensteine erreichen. Das Unternehmen konnte die Marke von drei Millionen installierter Ports übertreffen, und der dreitausendste „SAN Director“ mit der Be-

zeichnung SilkWorm 12 000 wurde ausgeliefert. Der SilkWorm erhielt darüber hinaus von einer britischen Fachzeitschrift die Auszeichnung „Produkt des Jahres“.

Nach einer Untersuchung des Marktforschungsunternehmens Dell'Oro ([www.delloro.com](http://www.delloro.com)) steht Brocade im Bereich der „Fabric Switches“ bei „Fibre Channel“-SANs an erster Stelle; der Marktanteil beträgt hier 58,8 Prozent. Im Segment „Directors“ konnte das Unternehmen seinen Anteil – gemessen an der Zahl der verkauften Ports – von 30,4 auf 32,2 Prozent verbessern. *jw*

Rang	Hersteller	Zuwachs
1	Brocade	+3 %
2	McData	+7 %
3	Cisco	+59 %
4	QLogic 4	-11 %

**Rangliste der Hersteller von „Fibre Channel“-Switches und „Host Bus“-Adaptoren für das 3. Quartal 2003.** (Quelle: Dell'Oro)

## Structured ASICs:

## Verbandsgründung soll Marktsegment etablieren

Eine Gruppe von Structured-ASIC-Herstellern und EDA-Firmen – der Structured-ASIC-Hersteller ChipExpress ([www.chipexpress.com](http://www.chipexpress.com)), der IP-Anbieter Lightspeed ([www.lightspeed.com](http://www.lightspeed.com)) sowie die beiden EDA-Tool-Hersteller Synplicity ([www.synplicity.com](http://www.synplicity.com)) und Tera Systems ([www.terasystems.com](http://www.terasystems.com)) – haben gemeinsam die „Structured ASIC Association“ (SAA) aus der Taufe geh-

ben. Die vier Gründungsmitglieder verfolgen das Ziel, Structured ASICs als eigenständiges Marktsegment zu etablieren und die Industrie über diese Technologie zu informieren.

Bei Structured ASICs handelt es sich um vordiffundierte Wafer, deren Chips aus vorgefertigten Logikzellen mit I/O-Modulen bestehen, die sich dann über ein oder mehrere kundenspezifische Metalisierungslagen programmieren lassen. Das Konzept ist dem von Gate Arrays ähnlich, wobei die Komplexität der Logikzellen heute über reine Gatter hinausgeht. Meist befinden sich auch SRAM-Speicherelemente auf dem Chip. Mit der zunehmenden Miniaturisierung der Transistorstrukturen steigen die Maskenkosten so dramatisch, dass die Industrie Wege sucht, mit einem Maskensatz möglichst hohe Volumina von gleichen Chips herzustellen. Da die kundenspezifische Programmierung durch die Metalisierungslagen mit einfacheren und damit auch kostengünstigeren Masken durchgeführt werden kann, verteilen sich die hohen Maskenkosten für die Strukturierung des eigentlichen Siliziums auf mehrere Nutzer. Wie bei FPGAs gibt es auch bei Structured ASICs Bausteine mit unterschiedlichen Größen, aus denen der Kunde auswählen kann. Gegenüber den in der Entwicklung langwierigeren und damit auch teureren Zellen-basierten ASICs entsteht bei der Implementierung in aller Regel ein gewisser Overhead, d.h., es bleiben programmierbare Zellen ungenutzt.

Die jüngst freigeschaltete Webseite des neugegründeten Verbandes ([www.structuredasic.com](http://www.structuredasic.com)) bietet direkten Zugriff auf alle News zum Thema. *gs*

## Mobiltelefonie:

## Abrechnung von Datendiensten

Der Siemens-Bereich Information and Communication Mobile ([www.siemens-mobile.de](http://www.siemens-mobile.de)) und Cisco Systems, Inc. ([www.cisco.com](http://www.cisco.com)), haben eine Zusammenarbeit vereinbart, um die für die Übertragung multimedialer Dienste über Mobilfunknetze erforderlichen technischen Einrichtungen gemeinsam zu entwickeln. Die Entwicklung umfasst neue, IP-basierende Verfahren für GPRS-, 3G/UMTS- und „Wireless LAN“-Netze, die speziell auf die Anforderungen des Geschäfts mit mobilen Datendiensten zugeschnitten sind.

Auf dem 3GSM-Kongress ([www.3gsm-worldcongress.com](http://www.3gsm-worldcongress.com)) in Cannes zeigten die Unternehmen ihre gemeinsam entwickelte „Intelligent Packet Solution“, mit der es möglich ist, die Datenströme in Echtzeit zu analysieren und daraus die Informationen abzuleiten, die den Netzbetreibern eine Tarifierung nicht nur nach Zeit und Volumen, sondern auch nach Inhalten und Nutzergruppen erlauben. Die Betreiber können so Datenanwendungen wie Video, Messaging, Kalender, Adressbücher und Spiele über alle Netzzugangsvorgänge zur Verfügung stellen und individuell abrechnen. Die Rolle von Siemens Mobile ist die eines Generalunternehmers, der sicherstellt, dass sich die IP-Komponenten nahtlos in die vorhandene Infrastruktur einfügen und die Netze auf die neuen technischen Möglichkeiten vorbereitet werden. *jw*

## Fertigungstechnik-Konferenz:

## „Embedded Passives“

Am 20. und 21. April veranstalten der FED (Fachverband Elektronik Design, [www.fed.de](http://www.fed.de)) und die IPC (Association Connecting Electronics Industries, [www.ipc.org](http://www.ipc.org)) gemeinsam die erste internationale Konferenz über in Leiterplatten eingebettete, passive Bauelemente. Die Integration von Widerständen, Kondensatoren und Induktivitäten in mehrlagige Leiterplatten erhöht nicht nur die Bauelementedichte und führt zu weiterer Miniaturisierung, sondern kann auch die Baugruppenfertigung rationalisieren. Die Konferenz informiert über neue Materialien, Design und Design-Werkzeuge, Fertigungstechnologien und das Lasertrimmen von Widerständen. Weitere Informationen bei der FED-Geschäftsstelle, Tel.: 030/8 34 90 59. *hs*

### Personen

● Der Board of Directors des Halbleiter-Herstellers AMD hat **Hector Ruiz**, seit April 2002 CEO des Unternehmens, jetzt auch zum Chairman gewählt. **Dr. William T. Edwards** wurde zum Chief Strategy Officer, **Ian Morris** zum Group Vice President der Personal Connectivity Solutions Group (PCSG) ernannt. Edwards ist in der neu geschaffenen Position des CSO verantwortlich für die Einrichtung des Office of Strategy and Technology (OST), dessen Ziele in der Erschließung neuer Märkte sowie in weiteren Führungsmöglichkeiten von AMD bestehen.

● Die Lütze-Gruppe ([www.luetze.de](http://www.luetze.de)) mit Sitz in Weinstadt hat mit **Udo Lütze** einen weiteren Geschäftsführer der Friedrich Lütze Elektro GmbH bestellt. Lütze übernimmt als drittes Mitglied der Geschäftsleitung die Betreuung der Tochtergesellschaften sowie die Leitung der Abteilung Internationales Marketing. *ro*

